

高测股份荣获国家科技进步奖

6月24日，2023年度国家科学技术奖在京揭晓，高测股份参与完成的“半导体材料高质高效磨粒加工关键技术与应用”获得国家科学技术进步奖二等奖。

国家科学技术奖由国务院设立，是我国最高级别的科技奖项，授予在各个领域实现重大技术突破、做出创造性贡献的中国公民和组织。

高测股份一直高度重视科技创新，具备形成高效研发体系、创新成果有效转化、科技创新和产业创新深度融合等优势，以原创性、颠覆性技术研发，聚力解决行业卡脖子难题。

2018年，公司基于多年自主创新的技术储备，正式“切”入半导体行业，推出截断机、金刚线切片机、研磨机等覆盖半导体单晶硅片加工核心工序，开启国产替代进程，并实现出口海外。

面向第三代半导体产业，公司创新推出国内首款高线速碳化硅金刚线切片专机，张力、线速等性能指标遥遥领先，进一步推动我国半导体行业关键技术的国产化进程，保障半导体产业供应链的安全与自主可控。

高测股份将持续加快关键核心技术攻关，不断提高产品质量、性能和价值，进一步促进产业结构调整、产业结构优化升级，为国家高水平科技自立自强、建设科技强国贡献高测力量。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/213043.html>